

DK 3.34 Df 0.0037  
@13GHzT<sub>g</sub> (DSC) 185°CT288(銅付)  
>120分

## 用途

## ネットワーク/ワイヤレス通信

ICTインフラ機器(スーパーコンピュータ、計測用機器)、アンテナ(基地局、車載ミリ波レーダ)、高周波用途 など

## MEGTRON6

Laminate

R-5775(N)\* R-5775(K) R-5775(G)

Prepreg

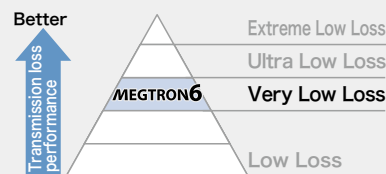
R-5670(N)\* R-5670(K) R-5670(G)

\*Low Dk glass cloth type

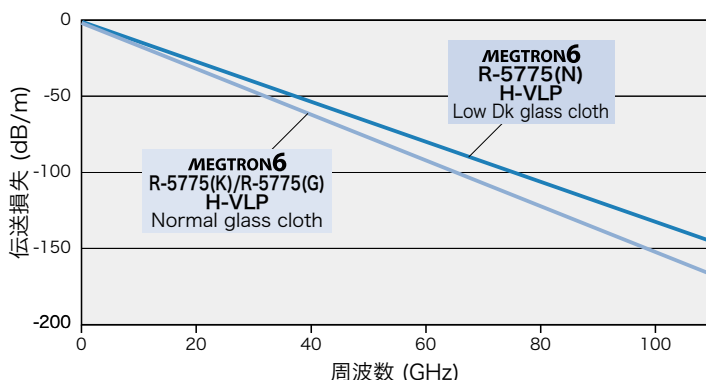
## 超低伝送損失・高耐熱多層基板材料

超高性能サーバやルータ向け材料のデファクトスタンダード。

低伝送ロスを実現し、超高性能サーバやルータの性能向上に貢献

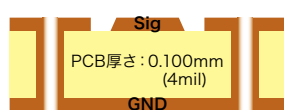


## 伝送損失比較



## 構成

マイクロストリップライン



試験方法	2ポート Sパラメータ
試験周波数	10MHz-110GHz
校正方法	TRL法
インピーダンス	50Ω(Z <sub>0</sub> )

層1: シグナルライン (ライン幅: 270μm、銅箔厚さ: 24μm)

層2: グランドプレーン (銅箔厚さ: 24μm)

## 高多層耐熱性

## 評価結果

ドリル径	φ0.3mm	
TH壁間距離	0.5mm	0.6mm
MEGTRON6 (Low Dk glass cloth)	pass	pass

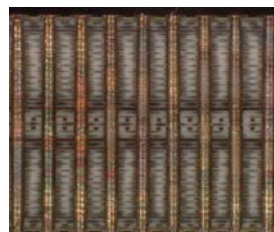
## 評価条件

260°Cリフロー×10回

## 構成

32層

板厚: 4.5mm



## 一般特性

項目		試験方法	条件	単位	MEGTRON6 R-5775(N) Low Dk glass cloth	MEGTRON6 R-5775(K)/R-5775(G) Normal glass cloth
ガラス転移温度(T <sub>g</sub> )		DSC	A	°C	185	185
熱膨張係数 (厚さ方向)	α1	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	45	45
	α2				260	260
T288(銅付)		IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>120	>120
比誘電率(Dk)	13GHz	平衡円板共振器法	C-24/23/50	—	3.34	3.62
誘電正接(Df)					0.0037	0.0046
銅箔引き剥がし強さ※	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.8	0.8

試験片の厚さは0.75mmです。

※ H-VLP銅箔

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

© Panasonic Industry Co., Ltd. 202410